

多様な基材にしっかり密着

高性能薄膜用 スパッタリング ターゲット材 NVF合金



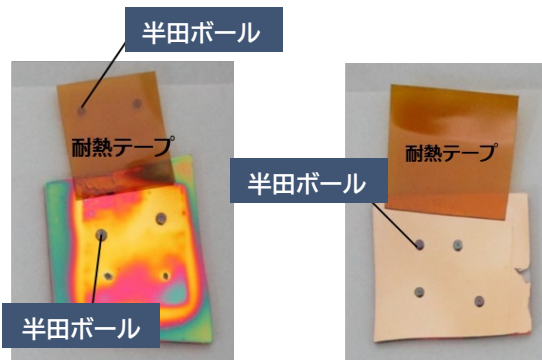
特 長

- ・ 樹脂、金属など多様な基材に対応
- ・ 研究用小ロットでもカスタマイズ
- ・ はんだ接合性(NVF-X合金)
- ・ 高耐酸化性(NVF-Z合金)

用 途

- ・ フィルム配線
- ・ 半導体実装基板
- ・ 固体酸化物燃料電池部材

■ はんだ接合性(NVF-X合金)



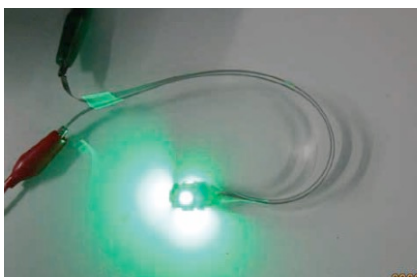
Cu単層

はんだボールが
剥がれている

Cu/NVF合金

はんだボール
の剥がれなし

厚さ0.1mmのPET上にCu積層膜を形成、
切断し、T5LEDに接続

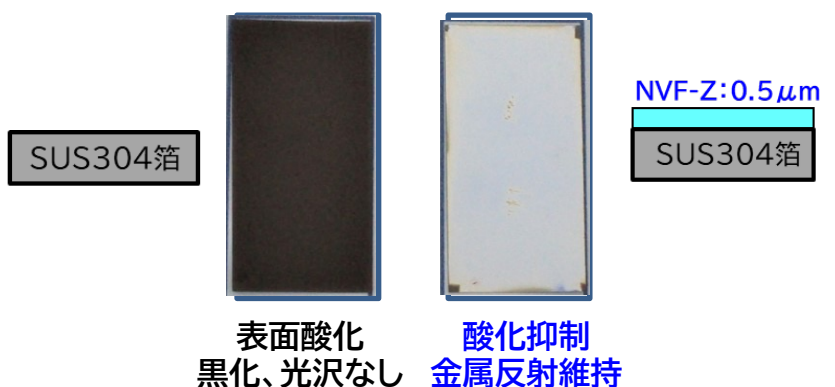


■ 各基材との密着性(NVF-X合金)

材質	MVF-56	NVF-X11A	Cu
PET(エステル系)	◎	◎	○
PI(イミド系)	◎	◎	○
PTFE(フッ素系)	×	△	×
密着性簡易評価 (テフロン系シートに 成膜後、 一部を引き剥がし)	 剥がれる (×)	 残る (○)	 剥がれる (×)

■ 高耐酸化性(NVF-Z合金)

大気中加熱900℃後の外観



表面酸化
黒化、光沢なし

酸化抑制
金属反射維持

